

证券代码：688028

证券简称：沃尔德

投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☒ 现场参观 ☒ 其他（券商组织的策略会）
参与单位名称	惠升基金 东方证券自营 西部证券、富安达基金、丹羿投资、知仁投资、利多星投资、华富基金、彤源投资、上海南土资管、海创私募、银河基金、汇正财经、利位资产、阳翔投资、华西银峰投资、朱雀基金、玖石投资、尚硕资本、鹤禧私募、金元顺安基金、国信弘盛私募、钦沐资产、山西证券、开源自营 开源证券、财通证券 大朴资产、华福证券、启赋私募、兴证全球、鸿坤资本、砥俊资产、东北证券、信达证券、北京怀信投资、远东国际、国盛证券、申万菱信基金、上海证券、东北证券、信达证券、上海昱奕资产、鑫融长弘投资、浙商证券、上海玖石投资、雲富投资、浙江邦栋投资、鹏盈资产、正兴资产、朔盈资产、个人投资者 部分会议参会者无法签署调研承诺函，但在交流活动中，我公司严格遵守相关规定，保证信息披露真实、准确、及时、公平，没有发生未公开重大信息泄露等情况。
时间及地点	7月8日 11:00-12:00（上海）、12:00-13:00（上海）、13:00-14:00（上海）、14:00-15:30（嘉兴沃尔德） 7月9日 14:00-15:30（嘉兴沃尔德）
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：陈继锋 副总经理、董事会秘书：陈焕超 证券事务代表/IR：沈李思
投资者关系活动主要内容介绍	风险提示： 1、新产品、新项目从技术研发到产业化过程中将可能遇到技术研发进度缓慢、技术及产品发展趋势判断失误以及技术成果转化不力等不确定性因素；同时需要在技术研发、工艺完善和设备选型方面进行大规模投资，以及后续市场开拓会面临较大的不确定性或者下游市场需求不及预期，无法如期为公司带来预期的收益，对公司的发展产生不利影响。特此郑重提醒广大投资者防范公司相关新业务的投资风险！

2、如涉及对行业预测/判断、公司发展战略和经营计划等相关内容，不能视作公司或公司管理层对行业、公司发展或业绩的承诺和保证，敬请广大投资者注意投资风险！

Q:公司金刚石功能材料业务在散热方面的研发及应用进展情况？

根据公司的发展战略和经营计划，将金刚石散热确立为中长期的战略级重大研发方向，争取与部分下游领先企业达成业务合作，推进金刚石散热从实验室研发走向工程化验证，从技术合作走向订单落地，为公司长远发展积蓄势能、抢占先机。

公司围绕硅/碳化硅/硅基 PCD 基金刚石衬底、多晶/单晶金刚石衬底、金刚石铜/铝等复合材料等进行产品研发，专注 GPU、CPU、高功率器件、射频器件、激光器等领域的应用研究及产业化工作。

（1）硅/碳化硅/硅基 PCD 基金刚石衬底方面

面向半导体晶圆应用的复合衬底解决方案，通过 CVD 技术在硅、碳化硅或硅基 PCD 晶圆表面沉积金刚石层，兼具硅、碳化硅或硅基 PCD 的半导体兼容性与金刚石材料的高热导性。

公司依靠自主研发的大腔室热丝 CVD 设备，成功研发出高平整度的硅、碳化硅或硅基 PCD 基金刚石衬底，最大尺寸 320mm*320mm，兼容直径 50mm-300mm 的主流晶圆尺寸；金刚石膜厚可调，总厚度偏差（TTV）小于 20 μm。目前已向中国台湾等地的客户交付部分产品，并积极配合客户要求进行产品的开发工作，整体进展在快速推进中。

公司依靠自主研发及合作开发的 MPCVD 设备，已成功制备直径 100mm 以内的硅基、碳化硅基和硅基 PCD 基的复合 CVD 金刚石衬底，并在精密加工后向部分客户交付验证，已经取得较好的验证结果。

（2）多晶/单晶金刚石衬底

通过微波、热丝、直流等 CVD 技术制备单晶/多晶金刚石热沉片，凭借高热导率与电绝缘特性，可高效降低器件热点温度并导出热量。

公司开发出适用于直接键合的超平整金刚石衬底，多晶最大直径 300mm，单晶最大尺寸 60*60mm；总厚度偏差（TTV）小于 2 μm；粗糙度（Ra）：多晶小于 1nm、单晶小于 0.5nm。

目前公司主要围绕芯片近结散热方向，向手机芯片、GPU、CPU 等海内外知名客户提供产品并进行验证，在部分验证节点已达到预期效果。

（3）金刚石铜/铝复合材料

金刚石与铜、铝复合而成高性能热管理材料，兼具金刚石高热导率与金属易连接或轻量化特征，为高功率、轻量化场景提供高性价比的散热解决方案，具备以下特点：

轻量化优势：密度低；热膨胀系数：匹配半导体器件、减少热应力导致失效风险；良好加工性：适配复杂结构设计；高性价比：经济适配更大批量场景。

目前公司主要围绕冷板散热，公司已开发出金刚石铜产品交付给下游冷板客户进行验证。

截至目前，虽然公司金刚石散热相关业务在技术研发方面已取得阶段性较好进展，已实现小部分营业收入，但该业务目前占公司总体营业收入比例较小，最终产品能否在客户验证成功具有一定的不确定性，距离规模化收入尚有较大差距，预计对 2026 年度营业收入贡献有限。敬请广大投资者客观认识该业务的产业化进程，注意投资风险。2026 年下半年，公司依据对客户推进进度的预判，已启动产能扩充工作，为后续订单落地做好前瞻性准备。

Q:公司金刚石功能材料业务在声学方面的研发及应用进展情况？

金刚石具备高刚度、高声学传播速率、轻质、高声学截止频率等优势，成为高端声学术振膜材料之一，公司通过 CVD（化学气相沉积）制备技术，成功研发用于高端汽车音响、HiFi 音响的 CVD 钻石声学术振膜产品，并建立从微波生长、激光切割、产品检验等环节的标准化作业流程，各环节均配备严格的生产管理规范，保障了工艺可靠性和产品合格率。

2026 年 4 月，伴随国内自主品牌量产新能源乘用车首次搭载了 CVD 钻石声学术振膜产品，公司率先实现了车规级 CVD 钻石声学术振膜产业化落地，市场反馈较好。与此同时，产品也陆续应用于国内知名品牌 HiFi 音响旗舰系列及高端 HiFi 耳机等多个场景。为此，公司依托“金刚石功能材料产业化项目（一期）”，加快项目建设工作，并科学制定产能提升计划，以便满足客户的需求，抢占更多市场份额，保持国内行业头部地位。

Q:请介绍下金刚石微钻/钻针产品在半导体领域和 PCB 领域的最新应用进

展情况？

公司金刚石微钻在半导体制造领域的硬脆材料微孔加工方面，主要面向中国及韩国市场，其在加工精度、孔壁光洁度、孔径一致性、加工效率等方面，已实现国内领先，并与日本佑能相关产品进行同台竞技；随着下游半导体领域景气度提升，该产品订单较为旺盛；未来随着全球半导体产业的投入力度加大，金刚石微钻的市场空间将逐步扩大，公司将抢占更多的市场份额。

公司金刚石微钻（俗称钻针）用于高端 PCB 微孔加工，是公司重要的下游应用方向之一，目前已与多家 PCB 厂商进行持续优化及验证工作，已经取得很多突破性进展，但尚未完全定型。后续将面临工艺匹配、成本控制、规模化稳定性等多重验证，请投资者务必注意投资风险。

公司金刚石微钻/钻针产品依托“金刚石微钻产业化项目（一期）”，正在加快项目建设工作，以实现产能的快速落地。

Q:请介绍钻石刀轮产品的应用情况？

公司钻石刀轮加工精度达到纳米级水平，产品厚度的公差在 1 微米以内，齿深或齿高的公差在±100 纳米以内，在 1-2 微米的范围内还会有形状、表面光洁度等更精细的极致要求；主要用于高端 LCD 显示面板、基板玻璃、触摸屏、盖板玻璃、AMOLED 面板等互联网和物联网智能终端部件的切割。产品的终端用户包括韩国 LG、京东方、天马微电子、华星光电、蓝思科技、群创光电、彩虹股份等知名制造商。

Q:请介绍公司的发展战略和发展方向？

公司依托长期积累的金刚石材料制备和精密加工能力，提出“三曲线”战略，形成“基础稳固—增长加速—前沿布局”的发展路径：

第一曲线（当前基石、稳健增长）：以超硬刀具为核心，适度拓展硬质合金刀具和陶瓷刀具，持续巩固公司高端刀具产品的应用版图及在高端制造领域的竞争力，跻身全球高端刀具第一阵营。

第二曲线（新的核心、快速增长）：重点发展壮大金刚石微钻、钻石声学振膜等已经产业化落地的高潜力业务，打造具备规模化能力与技术壁垒的新增长引擎。

第三曲线（前沿布局、加速推进）：围绕热管理、光学等方向推进金刚石功

	能材料、金刚石功能部件的应用，形成面向未来超大市场的技术储备力量与随时迎接巨大市场需求的战略弹性。 通过三曲线战略结构，公司将形成“基础支撑、增长驱动、前沿储备”协同演进的多层次产品体系。 Q: 请介绍以简易程序向特定对象发行股票竞价情况？ 公司本次简易程序向特定对象发行股票，于 2026 年 7 月 2 日上午 9:00-12:00 进行簿记，共计有 25 家投资者参与报价，有效申购金额为 10.354 亿元，有效申购倍数为 3.45 倍（拟募资 3 亿元），按竞价结果的发行价格为 150.18 元/股，因对应发行股数未触及发行股数上限的 70%（即本次募集资金上限 30,000.00 万元除以本次发行底价 96.35 元/股），按照《上海证券交易所证券发行与承销业务指南第 4 号——上市公司证券发行与承销备案（2025 年 3 月修订）》要求，向投资者出售的股票数量未达到拟公开发行股票数量 70%的为发行失败，故需对发行价格进行下修，下修后最终发行价格为 137.64 元/股，最终两家投资者入围，郭伟松获配金额 2.8 亿、财通基金获配金额 0.2 亿。
附件清单	无
日期	2026 年 7 月 10 日